

図表 2: 近年の半導体産業における主要な M&A 案件一覧

発表日	買収企業	被買収企業	ディール 総額 (Mn USD)	コメント
2014年12月	Cypress Semiconductor(米)	Spansion(米)	1,704	両社とも組み込み用メモリ/プロセッサ/マイコンを主力に持つ。ただ、メモリではSRAMとNOR型NAND、プロセッサ/マイコン分野でもプログラマブル製品に特化してきた旧Cypressと車載・産業用途に強いSpansionのマイコン製品でのすみ分けも企図していた。
2015年1月	Infineon Technologies AG(独)	International Rectifier Corporation(米)	2,262	GaNベースのパワー半導体技術の獲得を企図した買収。Infineon Technologyはシェアも大きく伸ばした。
2015年1月	Lattice Semiconductor(米)	Silicon Image(米)	449	Lattice社は豊富なIPを持つSilicon Imageを取り込むことでFPGAとしての競争力を高めようとの狙いがあった。
2015年2月	Intel Corporation(米)	Lantiq Deutschland GmbH(独)	406	Lantiq社の技術力を組み合わせることで、機器メーカーやサービスプロバイダー、ホームアプリケーションの開発企業向けに、包括的で幅広い接続ソリューションやホームクラウド技術を提供できるようにしたいとの狙いがあった。なお、Lantiq社は元々Infineonの有線通信部門だった。
2015年3月	富士通のLSI事業(日)	パナソニックのLSI事業(日)	NA	富士通とパナソニックのLSI設計・開発部門を統合し、日本政策投資銀行からの出資を受け入れLSI設計開発専門の新会社(ソシオネクスト)を設立。
2015年3月	NXP Semiconductors N.V.(蘭)	Freescale Semiconductor(米)	15,972	自動車向け半導体、汎用マイコン市場で高いシェアを握る2社の合併。合併後の新会社は自動車向けマイコンでは首位に迫る規模になった。
2015年3月	Microsemi(米)	Vitesse Semiconductor(米)	349	通信用のほか、軍事、宇宙航空など向け半導体を展開するMicrosemiがVitesseの持つイーサネット技術を取り込むことで、よりニッチな分野への製品展開を行うことを企図していた。
2015年3月	Uphill Investment Company(中)	Integrated Silicon Solution(米)	598	ISSIはファブレス半導体メーカーであり、自動車や通信、産業、デジタル家電などの市場に向けた高性能ICの設計/販売を手掛けている。
2015年4月	CITIC、Hua Capitalなどの投資家グループ	OmniVision Technologies(米)	1,831	イメージセンサー大手のOmniVisionを中国系投資ファンドが買収。今後需要増加が見込まれるイメージセンサー市場へのアクセスを企図した買収であると考えられる。
2015年5月	Microchip Technology(米)	Micrel(米)	768	マイコン、特に自動車向けマイコンに強みを持つMicrochipは積極的なM&Aを行っていたが、パワーマネジメント製品やタイミング製品などに強みを持つMicrelを買収した。
2015年5月	Avago Technologies(米)	Broadcom(米)	33,689	売上規模の劣るAvagoがBroadcomを買収するという小が大を飲み込む買収案件であり、当時は半導体業界最大の案件。LTE普及に向けた通信分野の強化が合併の狙いである可能性がある。
2015年6月	Intel Corporation(米)	Altera Corporation(米)	15,444	Intelが強化していた受託製造事業の大口顧客であることから同事業の安定やAlteraの主力である通信市場向けFPGAを手の中に入れることを企図していたと考えられる。
2015年8月	Qualcomm(米)	CSR Plc(英)	2,191	QualcommはBluetooth関連やオーディオ関連半導体に強みを持つCSRを買収。IoTや車載インフォテインメントなどの強化を企図している。
2015年10月	VeriSilicon Holdings(中)	Vivante Corporation(米)	NA	カスタムLSI設計を行うVeriSiliconが、GPUなどのIPを手掛けるVivanteを買収する。VeriSiliconは幅広いIPを保有するが、GPUコアやビジョンイメージプロセッサといったVivanteのIPを加えることで、顧客基盤を拡大させ、自動車市場への参入を狙う計画。
2015年10月	Skyworks Solutions(米)	PMC-Sierra(米)	2,171	アナログ半導体、RFなどのSkyworksの製品ポートフォリオにストレージ、PMC-Sierraの持つ光スイッチ、ネットワークインフラストラクチャソリューションなどを追加することでデータセンター向けの事業の拡大を企図している。
2015年10月	Western Digital Corporation(米)	SanDisk Corporation(米)	17,802	当時半導体企業による買収としては歴代2位の規模の案件。HDD大手のWestern DigitalがNANDなどを製造・販売するSanDiskを買収。HDD市場はクラウド化によって停滞していることから、メモリの製造までを手掛けることで新たな付加価値創造を行うことを企図したディール。
2015年10月	ソニー(日)	東芝(日)	154	ソニーによる東芝の大分工場の買収案件。当時財務的に苦しかった東芝が保有するCMOSなどを製造する大分工場を売却した。この工場を獲得したソニーはCMOS生産のさらなる増強を行った。
2015年11月	ON Semiconductor Corp(米)	Fairchild Semiconductor International(米)	2,223	アナログ半導体分野でもM&Aが起き始めたエポックメイキングな案件。高耐圧パワーデバイスに強いFairchildを買収することで、新規事業を強化することを企図している。

2016年1月	Microchip Technology(米)	Atmel Corporation(米)	3,278	MCUを主力とするAtmelをMicrochipが買収。Atmelは2015年9月にDialog Semiconductor社が買収することで合意したが、その後株価が大幅に下落したことなどから、Microchipに買収されるに至った。結果として、当時世界第3位のマイコンメーカーとなった。
2016年1月	Micron Technology(米)	Inotera Memories(台)	3,200	Micron TechnologyはNanya TechnologyからDRAMの合併会社であるInotera Memoriesの株式を買収。元々約33%を保有していたため、残りの67%を取得した。
2016年4月	Cypress Semiconductor(米)	Broadcom(米)のIoT向け無線事業	550	新生Broadcomがポートフォリオの整理の一環としてIoT向け無線事業をCypressへ売却した。CypressはSpansionとの合併で広範な半導体を扱えるようになったが、無線事業においては製品ポートフォリオが限定的であったため、補完の意味で買収を行った。
2016年6月	SMIC(中)	Lfoundry(伊)	55	LFoundryは、自動車やセキュリティ、産業用途などに向けたアナログ製品を専業として手掛けるファウンドリーである。中国国外での製造拡大を企図した買収だと考えられる。
2016年7月	Infineon Technologies AG(独)	Cree(米)のSiC事業	850	SiCを用いたパワー、RFデバイスを手掛ける子会社WolfspeedなどのSiCに関わる事業をInfineonが買収。SiCパワーデバイスでの攻勢を仕掛ける方針。さらに、InfineonはRFデバイスへのSiC応用を進め、5Gの実用化などで需要が拡大する見込みのRF市場でシリコンRFデバイスからの置き換えを狙う。買収契約完了後の2017年に対米外国投資委員会からの通達により、破談。
2016年7月	Softbank(日)	ARM Holdings(英)	30,165	ARM Holdingsは世界最大手のCPUのコアIPベンダーであり、スマートフォン用のSoCに搭載されるマイコンへIPを提供している。組込みCPUの業界標準のARMコアを設計・開発している。
2016年7月	Analog Devices(米)	Linear Technology Corporation(米)	12,995	Linear Technologyはアナログ半導体業界において、ハイエンドに特化して開発を行っており、結果として、40%程度の高い営業利益率を確保している。また、電源系アナログICを得意とするLinear Technologyを買収することは信号処理系アナログICを得意とするAnalog Devicesにとって補完関係にある。
2016年9月	ルネサス(日)	Intersil Corporation(米)	2,962	産業革新機構の出資以来経営再建を行ってきたルネサスだが、2015-6年には経営再建が一段落し、成長モードへ転換。電源ICを主力にするアナログICメーカーのIntersilはルネサスの主力であるマイコンと、Intersilの電源、ミックスドシグナルICを組み合わせた販売が行えるという製品面でのシナジーが期待できる。
2016年10月	Qualcomm(米)	NXP Semiconductors N.V.(蘭)	51,928	Freescallを買収し、自動車向けマイコンで首位を争うようになったNXPがQualcommに買収された。両社に製品における重複はなく、Qualcommの無線通信デバイスをNXPの自動車向けSoCに利用することで自動運転におけるシェア上昇を狙っている。
2016年11月	Siemens AG(独)	Mentor Graphics Corporation(豪)	4,148	Mentor GraphicsはアクティビストのElliott Managementから株主価値を高めるよう求められていた。Mentor GraphicsはICの設計のためのソフトウェア開発を行っており、SiemensのソフトウェアやSoC設計やEDAツールの強化を狙っている。
2016年12月	TDK(日)	InvenSense(米)	1,110	InvenSenseは慣性センサー、加速度センサー、ジャイロセンサーなど各種センサーを主力にするファブレスメーカーで、近年スマートフォンやゲーム機向けで急速にシェアを伸ばしていた企業。TDKはMicronas、Tronicsなどのセンサー企業を買収を続けている。
2017年3月	Intel Corporation(米)	Mobileye N.V.(以)	14,993	センサーフュージョン、マッピング、フロントおよびリアカメラ関連の技術を保有するMobileyeをIntelが買収。この買収により、IntelはADAS向けコンピュータビジョンチップ市場をほぼ独占することができる。
2017年9月	Canyon Bridge Capital Partners	Imagination Technologies(英)	781	AppleにiPhone向けSoCのGPUコアとして「PowerVR」を提供してきたImagination Technologiesの事業を買収。なお、Appleは2017年4月に2年以内にImagination TechnologiesのGPUコアの搭載を止めるとの通告があったため、同社の株価は大きく下落していた。
2017年9月	Bain Capital など	東芝メモリ(日)	10,644	会計問題に絡む東芝の財務体質改善のため、東芝がメモリ事業を売却した。ペインキャピタル連合は2020年ごろのIPOを目指すとのこと。
2017年10月	MediaTek(台)	Airoha Technology Corp(台)	69	無線通信向けIC設計を手掛けるAiroha TechnologyをMediatekが買収。
2017年11月	Marvell Technology Group Ltd(米)	Cavium, Inc.(米)	6,306	Caviumは幅広いネットワークチップや通信チップ、一方、Marvellは主にストレージ製品やイーサネットスイッチ、Wi-FiおよびBluetoothチップなどが主力製品である。そのため、重複が少ない。
2018年3月	Microchip Technology(米)	Microsemi(米)	9,836	Microchipは産業／自動車／コンシューマー市場向けの製品が多い。そのため、Microsemiの買収によってデータセンター／通信／防衛／航空市場のポートフォリオを拡充できる見込み。また、本買収によってアナログ製品群の拡充ができる見込み。
2018年3月	Cree(米)	Infineon(独)のRF事業	425	InfineonのRF事業をCreeが買収。Creeの子会社であるWolfspeedが手掛ける4Gおよび5Gの事業を強化することが狙い。本買収で技術、設計、パッケージング技術、製造技術、顧客などの面でWolfspeedの事業が強化されると述べている。InfineonのRFパワー事業はLDMOSやGaN-on-SiC技術に基づいた無線インフラパワーアンプ向けのトランジスタやMMICに強みを持つ。